

第 1 回反応装置セミナー
～反応装置の設計・操作の基礎から応用まで～

主 催：化学工学会 反応工学部会 触媒反応工学分科会
協 賛：粒子・流体プロセス部会 流動層分科会, SIS 部会 ダイナミックプロセス応用分科会,
触媒学会工業触媒研究会, 近畿化学協会, 他 (予定も含む)

日 時：2025 年 1 月 24 日 (金) 13 時 00 分～17 時 10 分
会 場：大阪公立大学文化交流センター ホール
(〒530-0001 大阪市北区梅田 1-2-2-600 大阪駅前第 2 ビル 6 階)
アクセス：JR 大阪駅中央改札口から徒歩約 10 分
(<https://www.omu.ac.jp/bunkakouryu-center/access/>)

プログラム：

- 13:00～13:05 主催者挨拶
- 13:05～13:50 「高分子微粒子ナノサイズ化のための反応器」
名古屋大学 山本 徹也 氏
- 13:50～14:35 「二元機能触媒を用いた CO₂ の回収および水素化に関する反応装置の研究開発」
国立研究開発法人産業技術総合研究所 小野 祐耶 氏
- 14:35～15:20 「セラミックスハニカムの反応器としての可能性と今後の展望」
日本ガイシ株式会社 村上 佳矢 氏
- 15:20～15:35 休憩
- 15:35～16:20 「微小空間と棒状触媒を用いた触媒反応プロセスの開発」
株式会社神戸製鋼所 松岡 亮 氏
- 16:20～17:05 「気液スラグ流反応器による水素化反応プロセスの強化」
大阪公立大学 堀江 孝史 氏
- 17:05～17:10 閉会の挨拶
- 18:00～20:00 懇親会 (当日ご案内します)

講演会参加費：化学工学会会員および協賛学会会員：2,200 円(消費税等(10%)：200 円を含む)、
賛助会員：無料、学生：無料、その他：5,500 円 (消費税等(10%)：500 円を含む)

懇親会参加費：5,500 円 (消費税等(10%)：500 円を含む)

申込方法：フォームへ入力 (<https://forms.office.com/r/M7UkW2kZes>)
もしくは電子メールにて氏名, 所属, 連絡先 (住所, 電話, 電子
メールアドレス), 講演会および懇親会双方の出欠を明記の上,
下記へお申し込み下さい。

申込締切日：2025 年 1 月 17 日 (金)

お問い合わせ・申込先：大阪公立大学 堀江孝史 (E-mail: horie@omu.ac.jp)

